

2026년 지능형반도체IT 소부장관련 산업체 재직자 실무교육 참가 교육생 모집

청주, 오창, 옥산, 오송 산단 소재 산업체 재직자분들을 대상으로 전문 기술 확보 및 연구개발 지원 활성화를 위한 「2026년 지능형반도체·IT 소부장사업 산업체 재직자 실무교육」을 다음과 같이 공고하오니, 참여를 희망하는 산업체 재직자 분들께서는 많은 관심과 참여 바랍니다.

2026년 10월 12일
산업통상자원부장관, 한국산업단지공단장, (재)충북테크노파크 원장

1 과 정 개 요

- **(신청자격)** 청주, 오창, 옥산, 오송 및 인근산단에 속해 있는 반도체·IT 소재, 부품, 장비에 대한 관련 기업(본사, 공장, 연구소 소재)
- **(추진일정)** 공고 및 접수

공고 시작	⇔	접수 마감	⇔	접수 확인	⇔	교육인원 및 일정 통보	⇔	교육진행
10월 12일 (월)		10월 29일 (목)		10월 29일 (목)		10월 29일 (목)		11월 2일~3일 (월~화)

※ 지원기관 일정에 따라 시행되며 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

- **(교육명)** 산업체 재직자 역량강화를 위한 몰드 및 레이저 마킹 공정 실습교육
- **(교육일정)** '26. 11. 2.(월) ~ 11. 3.(화) 10:00~17:00
- **(교육장소)** 충북테크노파크 반도체·IT소부장센터 교육실 및 실험실
(상세주소 : 충북 청주시 흥덕구 송절로 64번길 23)
- **(교육비)** 무료
- **(교육 프로그램 내용)**

구 분	시 간	강 의 내 용	시간	강 사
11.2 (월)	10:00~12:00	1. 본딩 공정 이론 교육 - 반도체 패키징 본딩 공정 개요 - Die Bonding 및 Flip Chip Bonding 공정 원리 - Epoxy Die Attach 및 Cure 공정 이해 - 본딩 주요 공정 변수 및 불량 사례	2	ASMPT : 장영철 수석
	12:00~13:00	중식	1	-
	13:00~15:00	2. 다이본더 장비 실습 교육 - ASMPT MEGA-G 장비 구성 및 안전교육 - 장비 UI 및 Programming 교육 - Epoxy 적용 시료 Loading 및 공정 조건 설정 - Die Pick-up, Alignment 및 Placement 실습	2	ASMPT : 장영복 차장
	15:00~17:00	3. 다이본딩 후처리 장비 실습 교육 - 대상 : 몰드 큐어 오븐 시스템, 초고온 신뢰성 챔버 - Epoxy 경화를 위한 온도·시간 조건 설정 및 장비 운용 - 경화 및 열처리 조건에 따른 공정 특성 이해 - 경화 및 열처리 후 다이본딩 시료 상태 확인	2	충북TP : 정준호 주임
11.3 (화)	10:00~12:00	1. 플립칩본더 장비 실습 교육 - ASMPT MEGA-P 장비 구성 및 안전교육 - 장비 UI 및 Programming 교육 - 시료 Loading 및 공정 조건 설정 - Flip Chip Alignment 및 Bonding 실습	2	ASMPT : 장영복 차장
	12:00~13:00	중식	1	-
	13:00~15:00	2. 플립칩본딩 공정 실습 교육 - Bonding Recipe 설정 - 칩 Alignment 및 공정 조건 조정 - Flip Chip Bonding 반복 실습 - 공정 조건에 따른 실장 상태 확인	2	ASMPT : 장영복 차장
	15:00~17:00	3. 본딩 공정 분석·평가 장비 실습 교육 - 대상 : 고배율 표면검사기, 접합강도 측정기, 3차원나노 단층촬영 엑스선현미경(XRM) - 본딩 시료 외관 및 접합 상태 확인 - 접합강도 측정 및 품질 평가 - XRM을 활용한 본딩부 내부 구조 및 결함 비파괴 관찰	2	충북TP : 정준호 주임

* 소형 칩 다이본더 및 고정밀 플립칩 본더 강사 : ASMPT 장영철 수석, 장영복 차장

2 신 청 방 법

- **(온라인)**
1. 충북테크노파크 홈페이지(www.cbtp.or.kr)내 공고 내용을 참고, 공고문 내 첨부서류를 다운로드하여 작성 후 신청 시 첨부하여 담당자 이메일로 (jhjeong@cbtp.or.kr) 신청

- **(제출서류)**

- 붙임1. 지능형반도체·IT소부장관련 산업체 재직자 실무교육 참가신청서 (1부)
붙임2. 기업정보 수집 및 이용동의서 (1부)
붙임3. 사업자등록증, 공장등록증, 기업부설연구소 인정서 중 사본1부 (택일)

3 유 의 사 항

- 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 인원 초과시 조기마감
- 청주산단, 오창산단, 오송산단, 옥산산단의 산업체 재직자를 위한 실무 교육진행으로 해당 산단에 포함되지 않는 산업체 재직자분들은 교육 대상에서 제외됨(학생, 취업준비생 등)

4 문 의 처

프로그램명	담당자명	전화번호	이메일	기관명
지능형반도체·IT 소부장관련 산업체 재직자 실무교육	정준호 주임 연구원	043-270-2316	jhjeong@cbtp.or.kr	(재)충북테크노파크